****

|  |  |
| --- | --- |
| **Domande dei lettori:** | **Contatto Stampa:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.it](http://www.congatec.it)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

****

*congatec garantisce il completo supporto delle nuove specifiche per Computer-on-Module COM Express 3.0, Qseven 2.1 e SMARC 2.0*

*Testo e foto disponibili presso:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**Comunicato stampa**

**congatec presenta la roadmap per le specifiche SMARC 2.0, Qseven 2.1 e COM Express 3.0**

**congatec annuncia il completo supporto alle nuove specifiche di SGET e PICMG relative ai Computer-on-Module**

**Deggendorf, Germania, 23 Febbraio 2016 \* \* \*** congatec, azienda leader nel settore dei moduli di elaborazione embedded, dei computer su scheda singola (SBC - Single Board Computer) e dei servizi EDM (Embedded Design and Manufacturing), ha annunciato alla recente edizione di Embedded World il proprio supporto alle nuove specifiche SMARC 2.0, Qseven 2.1 e COM Express 3.0 messe a punto da SGET e PICMG. I moduli conformi a questi standard sono già in fase di sviluppo e saranno annunciati contemporaneamente al lancio delle prossime generazioni di processori.

**La roadmap per SMARC e Qseven**

congatec prevede il completo supporto delle specifiche SMARC 2.0. I moduli conformi a queste specifiche saranno disponibili per l'intera gamma di processori supportati – da Intel® Atom™ alle varie versioni di ARM.

congatec inoltre continuerà a supportare tutta l'attuale gamma di processori utilizzati per lo sviluppo di progetti conformi allo standard Qseven 2.1.

La differenza fondamentale tra i due standard è rappresentata dal numero di interfacce supportate: QSeven prevede fino a 230 pin contro i 314 pin di SMARC 2.0. Di conseguenza SMARC è adatto per interfacciare sistemi più ricchi di funzionalità che richiedono ingombri ridotti mentre Qseven è ideale per lo sviluppo di schede carrier e moduli meno complessi e caratterizzati da spessori ridotti.

congatec ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo di questi standard. Per quanto riguarda le specifiche di Qseven e SMARC la società ha assunto il compito di curatore e si propone quindi come un fornitore di tecnologie chiave per progetti SFF (Small Form Factor) compatti basati su Computer-on-Module – mercato dove ha conquistano una posizione di leadership.

“Nel passaggio dalla versione 1.1 2.0 di SMARC – ha affermato Christian Eder, direttore marketing di congatec, oltre che membro del consiglio direttivo di SGET e curatore delle specifiche SMARC – siamo riusciti a dare una chiara prospettiva per il futuro a questo standard. Questa evoluzione ha portato all'aggiunta di molte nuove interfacce e all'eliminazione di parecchie funzionalità ormai superate. Sebbene i progetti basati sulla versione 1.1 potrebbero non risultare più compatibili con la nuova release 2.0, gli utenti potranno beneficiare della presenza di un gran numero di nuove caratteristiche”.

**La roadmap per COM Express**

La novità di maggior rilievo di COM Express 3.0 sarà la disponibilità di un nuovo pinout espressamente concepito per i Server-on-Module. Il target principale sarà rappresentato dai processori Intel® Xeon® e Intel Core™ per applicazioni server e dai processor AMD Embedded Serie R, mentre le piattaforme basate su ARM rappresentano un'altra possibile opzione.

“Tutte le nuove specifiche permettono agli sviluppatori di supportare le più recenti interfacce e sono caratterizzate da una nutrita serie di miglioramenti. Oltre SMARC 2.0. una versione completamente nuova ideata per lo sviluppo di sistemi multifuznione estremamente compatti, il nuovo pinout di COM Express 3.0 per i Server-on-Module è particolarmente innovativo. Esso consente di affrontare i nuovi mercati che prevedono l'utilizzo di server di nodi periferici decentralizzati e operanti in real-time in applicazioni quali streaming di contenuti multimediali, IoT, M2M, medicali e automazione" – ha spiegato Martin Danzer, product director Di congatec.

Grazie ai servizi di integrazione personalizzati di congatec, gli sviluppatori non avranno difficoltà a integrare le nuove revisioni nei progetti dei futuri sistemi. Poiché per numerose funzionalità è prevista la compatibilità con le versioni precedenti, in molti casi è possibile aggiornare le schede carrier esistenti con i nuovi moduli, in modo da garantire agli OEM la protezione degli investimenti effettuati nei progetti dei sistemi esistenti.

**Chi è congatec AG**
congatec AG ha sede a Deggendorf, in Germania, ed è fornitore leader di computer monoscheda (SBC), servizi EDM e moduli informatici industriali che utilizzano fattori di forma standard Qseven, COM Express, XTX e ETX. I prodotti congatec possono essere utilizzati in molteplici settori e applicazioni, tra cui l'automazione industriale, la tecnologia medica, le forniture per il settore automobilistico, aerospaziale e dei trasporti. Il suo principale campo di competenza e know-how tecnico comprende esclusive funzioni BIOS estese, così come pacchetti completi di supporto per driver e schede. Successivamente alla fase di progettazione, ai clienti viene fornita assistenza tramite una gestione estesa del ciclo di vita del prodotto. I prodotti dell'azienda sono fabbricati da fornitori di servizi specialistici conformemente ai moderni standard di qualità. Attualmente congatec vanta 177 dipendenti e divisioni a Taiwan, Giappone, Cina, USA,  Australia e Repubblica Ceca. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web [www.congatec.com](http://www.congatec.com) oppure tramite [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) e [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Intel Atom, Core, Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*